

# PDI系列

晶圆宏观/微观缺陷检测设备

Wafer Macro/Micro-Defect Inspection System



## 应用范围 Application Scope

### 晶圆类型

衬底片、外延片、腐蚀片等

### 晶圆尺寸

兼容4, 6, 8, 12英寸及其它非标尺寸

## 设备特点及优势 Product Introduction

### 超快检测

≥70 WPH @ 6",  
用于工艺过程检和  
出货终检

### 多种通道

集成明场(含微分干涉相差)和暗场,具备  
高分辨率与高灵敏度  
优势

### 多种扩展

支持厚度、倒角面  
幅,以及3D轮廓量  
测表征等功能

### 灵活选择

四款配置,可支持双  
面同时检测或翻面  
检测

中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号

## 软件算法 Software Algorithm

- ◆ 深度学习结合传统图像的自动检测算法
- ◆ 支持再分析, 缺陷分规和晶圆判级分拣
- ◆ 支持SECS/GEM协议, 设备与MES系统交互
- ◆ 支持配方自动训练、多区域检测功能
- ◆ 可扩展厚度、深度和表面轮廓参数量测功能
- ◆ 支持检测结果关联, 云服务数据追溯与共享

## 性能参数 Performance Parameters

技术参数	性能指标
Inspection Channels 检测通道	明场和暗场
Throughput 检测通量	≥70 WPH (6"), ≥40 WPH (8")
Sensitivity 灵敏度	0.3 μm
Repeatability 重复性	≥95%
Thickness 检测厚度	≤1.5 mm

## 检测图例 Inspected Defects

